

# 2025-2030年全球及中国半导体先进封装行业发展前景与投资战略规划 分析报告

## 目 录

### CONTENTS

#### ——综述篇——

#### 第1章：半导体先进封装行业综述及数据来源说明

##### 1.1 半导体先进封装行业界定

###### 1.1.1 半导体先进封装的界定

###### 1、定义

###### 2、特征

###### 3、术语

###### 1.1.2 半导体先进封装的分类

###### 1.1.3 半导体先进封装所处行业

###### 1.1.4 半导体先进封装行业监管

###### 1.1.5 半导体先进封装行业标准

##### 1.2 半导体先进封装产业画像

###### 1.2.1 半导体先进封装产业链结构梳理

###### 1.2.2 半导体先进封装产业链生态全景图谱

###### 1.2.3 半导体先进封装产业链区域热力图

##### 1.3 本报告数据来源及统计标准说明

###### 1.3.1 本报告研究范围界定

###### 1.3.2 本报告权威数据来源

###### 1.3.3 研究方法及统计标准

#### ——现状篇——

#### 第2章：全球半导体先进封装行业发展现状及趋势分析

##### 2.1 全球半导体先进封装行业发展历程

##### 2.2 全球半导体先进封装行业发展现状

##### 2.3 全球半导体先进封装市场规模体量

##### 2.4 全球半导体先进封装市场竞争格局

###### 2.4.1 全球半导体先进封装市场竞争格局

###### 2.4.2 全球半导体先进封装市场集中度

###### 2.4.3 全球半导体先进封装并购交易态势

##### 2.5 全球半导体先进封装区域发展格局

###### 2.5.1 全球半导体先进封装区域发展格局

###### 2.5.2 全球半导体先进封装国际贸易概况

###### 2.5.3 全球半导体先进封装国际贸易流向

##### 2.6 国外半导体先进封装发展经验借鉴

###### 2.6.1 半导体先进封装重点区域市场概况：美国

###### 2.6.2 半导体先进封装重点区域市场概况：日本

###### 2.6.3 国外半导体先进封装发展经验借鉴

##### 2.7 全球半导体先进封装市场前景预测

##### 2.8 全球半导体先进封装发展趋势洞悉

#### 第3章：中国半导体先进封装行业发展现状及竞争状况

##### 3.1 中国半导体先进封装行业发展历程

##### 3.2 中国半导体先进封装市场主体类型

###### 3.2.1 半导体先进封装市场参与者

###### 3.2.2 半导体先进封装企业入场方式

##### 3.3 中国半导体先进封装运营模式分析

###### 3.3.1 垂直整合制造商（IDM）

###### 3.3.2 独立封测代工厂（OSAT）

##### 3.4 中国半导体先进封装市场供给/生产

###### 3.4.1 半导体先进封装占比

###### 3.4.2 半导体先进封装企业

- 3.4.3 半导体先进封装能力
- 3.6 中国半导体先进封装市场需求**
  - 3.5.1 半导体先进封装销售业务模式
  - 3.5.2 半导体先进封装市场需求特征
  - 3.5.3 半导体先进封装市场需求现状
  - 3.5.4 半导体先进封装市场价格走势
- 3.6 中国半导体先进封装行业盈利能力**
- 3.7 中国半导体先进封装市场规模体量**
- 3.8 中国半导体先进封装市场竞争态势**
  - 3.8.1 半导体先进封装市场竞争格局
  - 3.8.2 半导体先进封装市场集中度
  - 3.8.3 半导体先进封装跨国企业在华布局
- 3.9 中国半导体先进封装市场投融资态势**
  - 3.9.1 半导体先进封装企业融资动态
  - 3.9.2 半导体先进封装企业IPO动态
  - 3.9.3 半导体先进封装企业投资动态
  - 3.9.4 半导体先进封装企业兼并重组
- 3.10 中国半导体先进封装行业发展痛点分析**
- 第4章：半导体先进封装技术及原料设备配套市场分析**
  - 4.1 半导体先进封装行业竞争壁垒**
    - 4.1.1 半导体先进封装市场核心竞争力（护城河）
    - 4.1.2 半导体先进封装行业进入壁垒（竞争壁垒）
    - 4.1.3 半导体先进封装行业潜在进入者威胁分析
  - 4.2 半导体先进封装行业技术进展**
    - 4.2.1 半导体先进封装技术路线全景图
    - 4.2.2 国内外半导体先进封装技术对比
    - 4.2.3 半导体先进封装专利申请/学术文献
    - 4.2.4 半导体先进封装技术研发方向/未来研究重点
  - 4.3 集成电路设计**
    - 4.3.1 集成电路设计发展概况
    - 4.3.2 集成电路设计业发展现状
      - 1、产业发展增速减缓增幅合理
      - 2、企业数量不断增加
      - 3、产业集中度提高
      - 4、技术能力大幅提升
    - 4.3.3 集成电路设计业政策分析
    - 4.3.4 集成电路设计发展策略分析
    - 4.3.5 集成电路设计业“十四五”发展预测
  - 4.4 半导体先进封装成本结构分析**
  - 4.5 半导体先进封装材料**
    - 4.5.1 半导体先进封装材料采购模式
    - 4.5.2 半导体先进封装材料供应概况
    - 4.5.3 半导体先进封装材料价格波动
    - 4.5.4 引线框架
    - 4.5.5 封装基板
    - 4.5.6 键合线
    - 4.5.7 环氧塑封料（EMC）
    - 4.5.8 半导体CMP材料
    - 4.5.9 光敏性聚酰亚胺（PSPI）
    - 4.5.10 电镀液
  - 4.6 半导体先进封装设备供应**
    - 4.6.1 半导体先进封装设备市场概况
    - 4.6.2 贴片机
    - 4.6.3 引线机
    - 4.6.4 划片和检测设备
    - 4.6.5 切筋与塑封设备
    - 4.6.6 电镀设备
  - 4.7 半导体先进封装供应链面临的挑战**
- 第5章：中国半导体先进封装细分产品市场发展分析**

- 5.1 半导体先进封装行业细分市场现状
    - 5.1.1 半导体先进封装细分产品综合对比
    - 5.1.2 半导体先进封装细分市场发展概况
    - 5.1.3 半导体先进封装细分市场结构分析
  - 5.2 半导体先进封装细分市场：WLP（晶圆级封装）
    - 5.2.1 WLP（晶圆级封装）概述
    - 5.2.2 WLP（晶圆级封装）市场概况
    - 5.2.3 WLP（晶圆级封装）企业布局
    - 5.2.4 WLP（晶圆级封装）发展趋势
  - 5.4 半导体先进封装细分市场：SiP（系统级封装）
    - 5.4.1 SiP（系统级封装）概述
    - 5.4.2 SiP（系统级封装）市场概况
    - 5.4.3 SiP（系统级封装）企业布局
    - 5.4.4 SiP（系统级封装）发展趋势
  - 5.3 半导体先进封装细分市场：2.5D/3D立体封装
    - 5.3.1 2.5D/3D立体封装概述
    - 5.3.2 2.5D/3D立体封装市场概况
    - 5.3.3 2.5D/3D立体封装企业布局
    - 5.3.4 2.5D/3D立体封装发展趋势
  - 5.5 半导体先进封装细分市场：Chiplet（芯粒）
    - 5.5.1 Chiplet（芯粒）概述
    - 5.5.2 Chiplet（芯粒）市场概况
    - 5.5.3 Chiplet（芯粒）企业布局
    - 5.5.4 Chiplet（芯粒）发展趋势
  - 5.6 半导体先进封装细分市场战略地位分析
- 第6章：中国半导体先进封装细分应用市场发展分析**
- 6.1 半导体先进封装应用场景&领域分布
    - 6.1.1 半导体先进封装应用场景分析
    - 6.1.2 半导体先进封装应用领域分布
  - 6.2 半导体先进封装细分应用：通讯设备
    - 6.2.1 通讯设备领域半导体先进封装应用概述
    - 6.2.2 通讯设备领域半导体先进封装市场现状
    - 6.2.3 通讯设备领域半导体先进封装需求潜力
  - 6.3 半导体先进封装细分应用：汽车电子
    - 6.3.1 汽车电子领域半导体先进封装应用概述
    - 6.3.2 汽车电子领域半导体先进封装市场现状
    - 6.3.3 汽车电子领域半导体先进封装需求潜力
  - 6.4 半导体先进封装细分应用：新能源
    - 6.4.1 新能源领域半导体先进封装应用概述
    - 6.4.2 新能源领域半导体先进封装市场现状
    - 6.4.3 新能源领域半导体先进封装需求潜力
  - 6.5 半导体先进封装细分应用：消费电子
    - 6.5.1 消费电子领域半导体先进封装应用概述
    - 6.5.2 消费电子领域半导体先进封装市场现状
    - 6.5.3 消费电子领域半导体先进封装需求潜力
  - 6.6 半导体先进封装细分应用市场战略地位分析
- 第7章：全球及中国半导体先进封装企业案例解析**
- 7.1 全球及中国半导体先进封装企业梳理与对比
  - 7.2 全球半导体先进封装企业案例分析（不分先后，可指定）
    - 7.2.1 安靠科技（Amkor）
      - 1、企业基本信息
      - 2、企业经营情况
      - 3、半导体先进封装业务布局
      - 4、半导体先进封装在华布局
    - 7.2.2 三星电子
      - 1、企业基本信息
      - 2、企业经营情况
      - 3、半导体先进封装业务布局
      - 4、半导体先进封装在华布局

### 7.2.3 英特尔 (Intel)

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、半导体先进封装业务布局
- 4、半导体先进封装在华布局

## 7.3 中国半导体先进封装企业案例分析 (不分先后, 可指定)

### 7.3.1 甬矽电子 (宁波) 股份有限公司

- 1、企业基本信息
  - (1) 发展历程
  - (2) 基本信息
  - (3) 经营范围及主营业务
- 2、企业经营情况
- 3、企业资质能力
- 4、半导体先进封装专利技术
- 5、半导体先进封装产品布局
- 6、半导体先进封装应用领域
- 7、企业业务布局战略&优劣势

### 7.3.2 通富微电子股份有限公司

- 1、企业基本信息
  - (1) 发展历程
  - (2) 基本信息
  - (3) 经营范围及主营业务
- 2、企业经营情况
- 3、企业资质能力
- 4、半导体先进封装专利技术
- 5、半导体先进封装产品布局
- 6、半导体先进封装应用领域
- 7、企业业务布局战略&优劣势

### 7.3.3 天水华天科技股份有限公司

- 1、企业基本信息
  - (1) 发展历程
  - (2) 基本信息
  - (3) 经营范围及主营业务
- 2、企业经营情况
- 3、企业资质能力
- 4、半导体先进封装专利技术
- 5、半导体先进封装产品布局
- 6、半导体先进封装应用领域
- 7、企业业务布局战略&优劣势

### 7.3.4 江苏长电科技股份有限公司

- 1、企业基本信息
  - (1) 发展历程
  - (2) 基本信息
  - (3) 经营范围及主营业务
- 2、企业经营情况
- 3、企业资质能力
- 4、半导体先进封装专利技术
- 5、半导体先进封装产品布局
- 6、半导体先进封装应用领域
- 7、企业业务布局战略&优劣势

### 7.3.5 智路建广紫光联合体

- 1、企业基本信息
  - (1) 发展历程
  - (2) 基本信息
  - (3) 经营范围及主营业务
- 2、企业经营情况
- 3、企业资质能力
- 4、半导体先进封装专利技术
- 5、半导体先进封装产品布局

- 6、半导体先进封装应用领域
- 7、企业业务布局战略&优劣势
- 7.3.6 气派科技股份有限公司
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
    - (3) 经营范围及主营业务
  - 2、企业经营情况
  - 3、企业资质能力
  - 4、半导体先进封装专利技术
  - 5、半导体先进封装产品布局
  - 6、半导体先进封装应用领域
  - 7、企业业务布局战略&优劣势
- 7.3.7 池州华宇电子科技股份有限公司
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
    - (3) 经营范围及主营业务
  - 2、企业经营情况
  - 3、企业资质能力
  - 4、半导体先进封装专利技术
  - 5、半导体先进封装产品布局
  - 6、半导体先进封装应用领域
  - 7、企业业务布局战略&优劣势
- 7.3.8 华润微电子有限公司
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
    - (3) 经营范围及主营业务
  - 2、企业经营情况
  - 3、企业资质能力
  - 4、半导体先进封装专利技术
  - 5、半导体先进封装产品布局
  - 6、半导体先进封装应用领域
  - 7、企业业务布局战略&优劣势
- 7.3.9 四川遂宁市利普芯微电子有限公司
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
    - (3) 经营范围及主营业务
  - 2、企业经营情况
  - 3、企业资质能力
  - 4、半导体先进封装专利技术
  - 5、半导体先进封装产品布局
  - 6、半导体先进封装应用领域
  - 7、企业业务布局战略&优劣势
- 7.3.10 佛山市蓝箭电子股份有限公司
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
    - (3) 经营范围及主营业务
  - 2、企业经营情况
  - 3、企业资质能力
  - 4、半导体先进封装专利技术
  - 5、半导体先进封装产品布局
  - 6、半导体先进封装应用领域
  - 7、企业业务布局战略&优劣势

——展望篇——

第8章：中国半导体先进封装行业政策环境及发展潜力

- 8.1 半导体先进封装行业政策汇总解读
    - 8.1.1 中国半导体先进封装行业政策汇总
    - 8.1.2 中国半导体先进封装行业发展规划
    - 8.1.3 中国半导体先进封装重点政策解读
  - 8.2 半导体先进封装行业PEST分析图
  - 8.3 半导体先进封装行业SWOT分析图
  - 8.4 半导体先进封装行业发展潜力评估
  - 8.5 半导体先进封装行业未来关键增长点
  - 8.6 半导体先进封装行业发展前景预测（未来5年预测）
  - 8.7 半导体先进封装行业发展趋势洞悉
    - 8.7.1 整体发展趋势
    - 8.7.2 监管规范趋势
    - 8.7.3 技术创新趋势
    - 8.7.4 细分市场趋势
    - 8.7.5 市场竞争趋势
    - 8.7.6 市场供需趋势
- 第9章：中国半导体先进封装行业投资策略及规划建议**
- 9.1 半导体先进封装行业投资风险预警
    - 9.1.1 半导体先进封装行业投资风险预警
    - 9.1.2 半导体先进封装行业投资风险应对
  - 9.2 半导体先进封装行业投资机会分析
    - 9.2.1 半导体先进封装产业链薄弱环节投资机会
    - 9.2.2 半导体先进封装行业细分领域投资机会
    - 9.2.3 半导体先进封装行业区域市场投资机会
    - 9.2.4 半导体先进封装产业空白点投资机会
  - 9.3 半导体先进封装行业投资价值评估
  - 9.4 半导体先进封装行业投资策略建议
  - 9.5 半导体先进封装行业可持续发展建议

## 图表目录

- 图表1：半导体先进封装的定义
- 图表2：半导体先进封装的特征
- 图表3：半导体先进封装专业术语说明
- 图表4：半导体先进封装近义术语辨析
- 图表5：半导体先进封装的分类
- 图表6：本报告研究领域所处行业（一）
- 图表7：本报告研究领域所处行业（二）
- 图表8：半导体先进封装行业监管
- 图表9：半导体先进封装标准化建设进程
- 图表10：半导体先进封装国际标准
- 图表11：半导体先进封装中国标准
- 图表12：半导体先进封装即将实施标准
- 图表13：半导体先进封装产业链结构梳理
- 图表14：半导体先进封装产业链生态全景图谱
- 图表15：半导体先进封装产业链区域热力图
- 图表16：本报告研究范围界定
- 图表17：本报告权威数据来源
- 图表18：本报告研究方法及统计标准
- 图表19：全球半导体先进封装行业发展历程
- 图表20：全球半导体先进封装行业发展现状
- 图表21：全球半导体先进封装市场规模体量
- 图表22：全球半导体先进封装市场竞争格局
- 图表23：全球半导体先进封装市场集中度
- 图表24：全球半导体先进封装并购交易态势
- 图表25：全球半导体先进封装区域发展格局

- 图表26: 全球半导体先进封装国际贸易概况
- 图表27: 全球半导体先进封装国际贸易流向示意图
- 图表28: 美国半导体先进封装发展概况
- 图表29: 日本半导体先进封装发展概况
- 图表30: 国外半导体先进封装发展经验借鉴
- 图表31: 全球半导体先进封装市场前景预测 (2025-2030年)
- 图表32: 全球半导体先进封装发展趋势洞悉
- 图表33: 中国半导体先进封装发展历程
- 图表34: 中国半导体先进封装市场参与者类型
- 图表35: 中国半导体先进封装企业入场方式
- 图表36: IDM模式企业业务环节
- 图表37: 中国半导体先进封装占全球比重
- 图表38: 中国半导体先进封装企业数量
- 图表39: 中国半导体先进封装能力
- 图表40: 中国半导体先进封装市场需求
- 图表41: 中国半导体先进封装销售业务模式
- 图表42: 中国半导体先进封装市场需求特征分析
- 图表43: 中国半导体先进封装需求现状
- 图表44: 中国半导体先进封装市场价格走势分析
- 图表45: 中国半导体先进封装行业经营效益
- 图表46: 中国半导体先进封装市场规模体量
- 图表47: 中国半导体先进封装市场竞争格局
- 图表48: 中国半导体先进封装市场集中度
- 图表49: 半导体先进封装跨国企业在华布局
- 图表50: 半导体先进封装跨国企业在华布局策略
- 图表51: 中国半导体先进封装投融资动态及热门赛道
- 图表52: 半导体先进封装融资事件
- 图表53: 半导体先进封装融资规模
- 图表54: 半导体先进封装热门融资赛道
- 图表55: 中国半导体先进封装企业IPO动态
- 图表56: 中国半导体先进封装投资/跨界投资
- 图表57: 中国半导体先进封装行业兼并重组动态
- 图表58: 中国半导体先进封装兼并重组分析
- 图表59: 中国半导体先进封装行业发展痛点分析
- 图表60: 中国半导体先进封装技术及原料设备配套市场分析
- 图表61: 半导体先进封装市场核心竞争力 (护城河)
- 图表62: 半导体先进封装行业进入壁垒分析
- 图表63: 半导体先进封装行业退出壁垒分析
- 图表64: 半导体先进封装行业潜在进入者威胁
- 图表65: 半导体先进封装技术路线全景图
- 图表66: 国内外半导体先进封装技术对比
- 图表67: 半导体先进封装专利申请/学术文献
- 图表68: 半导体先进封装技术研发方向/未来研究重点
- 图表69: 2010-2024年中国集成电路设计业销售额和增长情况 (单位: 亿元, %)
- 图表70: 2011-2024年中国集成电路设计企业数量情况 (单位: 家)
- 图表71: 2019-2024年国内TOP10 IC设计企业上榜门槛及规模占比情况
- 图表72: 集成电路设计行业政策分析
- 图表73: 集成电路设计业新发展策略
- 图表74: 2025-2030年国内集成电路设计业市场规模预测 (单位: 亿元)
- 图表75: 半导体先进封装成本结构分析
- 图表76: 半导体先进封装材料采购模式
- 图表77: 半导体先进封装材料供应概况
- 图表78: 半导体先进封装材料价格波动
- 图表79: 半导体先进封装设备市场概况
- 图表80: 半导体先进封装供应链面临的挑战
- 图表81: 半导体先进封装细分产品综合对比
- 图表82: 半导体先进封装细分市场发展概况
- 图表83: 半导体先进封装细分市场结构分析
- 图表84: WLP (晶圆级封装) 概述

图表85: WLP (晶圆级封装) 市场概况  
图表86: WLP (晶圆级封装) 企业布局  
图表87: WLP (晶圆级封装) 发展趋势  
图表88: SiP (系统级封装) 概述  
图表89: SiP (系统级封装) 市场概况  
图表90: SiP (系统级封装) 企业布局  
图表91: SiP (系统级封装) 发展趋势  
图表92: 2.5D/3D立体封装概述  
图表93: 2.5D/3D立体封装市场概况  
图表94: 2.5D/3D立体封装企业布局  
图表95: 2.5D/3D立体封装发展趋势  
图表96: Chiplet (芯粒) 概述  
图表97: Chiplet (芯粒) 市场概况  
图表98: Chiplet (芯粒) 企业布局  
图表99: Chiplet (芯粒) 发展趋势  
图表100: 半导体先进封装细分市场战略地位分析  
图表101: 半导体先进封装应用场景分析  
图表102: 半导体先进封装应用领域分布  
图表103: 通讯设备领域半导体先进封装应用概述  
图表104: 通讯设备领域半导体先进封装市场现状  
图表105: 通讯设备领域半导体先进封装需求潜力  
图表106: 汽车电子领域半导体先进封装应用概述  
图表107: 汽车电子领域半导体先进封装市场现状  
图表108: 汽车电子领域半导体先进封装需求潜力  
图表109: 新能源领域半导体先进封装应用概述  
图表110: 新能源领域半导体先进封装市场现状  
图表111: 新能源领域半导体先进封装需求潜力  
图表112: 消费电子领域半导体先进封装应用概述  
图表113: 消费电子领域半导体先进封装市场现状  
图表114: 消费电子领域半导体先进封装需求潜力  
图表115: 半导体先进封装细分应用波士顿矩阵分析  
图表116: 全球及中国半导体先进封装企业案例解析  
图表117: 全球及中国半导体先进封装企业梳理与对比  
图表118: 全球半导体先进封装企业案例分析说明  
图表119: 安靠科技 (Amkor) 基本情况  
图表120: 安靠科技 (Amkor) 经营情况  
略.....完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容, 请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线: 400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件: [service@qianzhan.com](mailto:service@qianzhan.com)

或登录网站: <https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务!